# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-183665

(43)Date of publication of application: 15.07.1997

(51)Int.Cl.

CO4B 35/584

(21)Application number: 07-343825

(71)Applicant: TONEN CORP

(22)Date of filing:

28.12.1995

(72)Inventor: NAGAHARA TATSURO

MATSUO HIDEKI

### (54) COATING COMPOSITION FOR OPTICAL DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce the subject composition capable of obtaining a uniform film thickness distribution in a dip coating method by incorporating a solvent having a boiling point within a specified temp. range and a polysilazane in a specified weight range.

SOLUTION: In this coating composition for optical devices, at least one kind of solvent having the b.p. in a range of room temp to 120° C and 0.1–20wt.% polysilazane per total wt. of the composition (e.g.: the polysilazane, etc., having a main skeleton expressed by the formula (R1, R2 and R3 are each H, an alkyl, an aryl and a group whose part connected directly to Si is carbon, etc., and at least one among R1, R2 and R3 is H) and having a number average mol.wt. of 100–50000 are incorporated. The uniform film thickness distribution capable of being permitted for the optical devices is obtained even if a taking up speed is increased in the dip coating method, and the production efficiency of an optical device is increased since the solvent is more rapidly dried when a parts or a substrate of the optical device such as liquid crystal display device is coated by the dip coating method using this coating composition.

$$- \leftarrow \begin{array}{c} R^1 \\ \vdots \\ S^1 \\ R^k \end{array}$$

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-183665

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 4 B 35/584

C 0 4 B 35/58

102A

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平7-343825

(71)出願人 390022998

東燃株式会社

(22)出顧日

平成7年(1995)12月28日

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号

(72)発明者 長原 達郎

埼玉県入間郡大井町西鶴ヶ岡1丁目3番1

号 東燃株式会社総合研究所内

(72)発明者 松尾 英樹

埼玉県入間郡大井町西鶴ヶ岡1丁目3番1

号 東燃株式会社総合研究所内

(74)復代理人 弁理士 石田 敬 (外4名)

#### (54) 【発明の名称】 光学装置用コーティング組成物

#### (57)【要約】

【課題】 浸漬塗布法において均一な膜厚分布が得られ るポリシラザン含有コーティング組成物を提供するこ と。

【解決手段】 室温~120℃の沸点を有する少なくと も1種の溶媒と、全組成物重量に対して0.1~20重 量%のポリシラザンとを含む光学装置用コーティング組 成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 室温~120℃の沸点を有する少なくとも1種の溶媒と、全組成物重量に対して0.1~20重量%のポリシラザンとを含む光学装置用コーティング組成物。

1

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置をは じめとする光学装置、特にこのような装置に用いられる 部品や透明基板に各種SiO2 系保護被膜を施すための 10 コーティング組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】液晶表示装置をはじめとする光学装置の 需要が急速に高まりつつある。このような光学装置には 一般に透明基板が用いられており、低コスト化を進める ためにより安価な基板、例えばソーダガラス基板を使用 することが望まれている。ソーダガラス基板を用いた場 合、基板から溶出するアルカリ成分が、例えば液晶表示 装置の性能に悪影響を及ぼす恐れがある。このため、一 般にこのような基板には、アルカリ成分の移行を遮断す 20 るために表面にバリヤ層がコーティングされる。また、 液晶表示装置では、基板からのアルカリ成分以外にも空 気中の湿分や酸素などを遮断して内部の液晶を保護する 必要があり、基板へのコーティングの他、組み立てられ た液晶表示装置の部品や完成品にオーバーコートとして バリヤ層を施すことが望まれる場合もある。バリヤ層と しては、透明性、屈折率、などの光学的要件が好ましい ことから、

①ブルーゲル法によるアルコキシシラン由来のSiО₂ 被膜、及び②ポリシラザンのキシレン溶液由来のSiО 30 2 被膜が知られている。これらいずれの被膜も、一般に その前駆体溶液に光学装置やその基板を浸漬した後、そ の塗膜を焼成することによって施工されている。

### [00003]

【発明が解決しようとする課題】前者のゾルーゲル法 は、500℃以上の高温の焼成処理が必要であるため歩 留りが悪く、また形成されるバリヤ層の緻密性が低いた め所望のバリヤ性が得られにくいという問題があった。 後者のポリシラザンを利用した方法によると、より緻密 で高いバリヤ性を示す被膜が得られる。しかしながら、 浸漬法で塗布する場合、浸漬後に被塗工物を引き上げた 際に溶媒が適切な速度で乾燥しないとコーティング液が 重力で下方に垂れ流れるために光学装置として許容でき ない不均一な膜厚分布をもたらすことがわかった。この ことは、被塗工物の引き上げ速度を上げて被覆物の生産 効率を高めようとすればするほど大きな問題となり、従 来より用いられているキシレン溶媒は光学装置のさらな る製造コストの低下を進める上で障害となることがわか った。従って、本発明の目的は、上記のような問題を解 決し、液晶表示装置のような光学装置にとって許容でき 50

る均一な膜厚分布 (一般に±5%以内が好ましい)をもたらし且つ、該光学装置の生産効率をさらに高めることを可能とするポリシラザン含有コーティング組成物を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明によると、上記の 課題は、

(1)室温~120℃の沸点を有する少なくとも1種の溶媒と、全組成物重量に対して0.1~20重量%のポリシラザンとを含む光学装置用コーティング組成物によって達成される。

【0005】本発明の好ましい実施態様を以下に列挙す ス

- (2) 室温~120℃の沸点を有する少なくとも1種の 密媒と、全組成物重量に対して0.2~10重量%のポ リシラザンとを含む光学装置用コーティング組成物。
- (3) 前記溶媒の沸点が50~100℃である、(1) 又は(2)項に記載の光学装置用コーティング組成物。
- (4) 前記溶媒が脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及び 脂環式炭化水素から成る群より選ばれた少なくとも2種 の溶媒混合物である、(1)~(3)項のいずれか一項 に記載の光学装置用コーティング組成物。

【 O O O 6 】 (5) さらに別の芳香族炭化水素を全組成 物重量に対して1~10重量%含有する、(1)~

- (4)項のいずれか一項に記載の光学装置用コーティング組成物。
- (6) さらに触媒をポリシラザン重量に対して0.01 ~10重量%含有する、(1)~(5)項のいずれか一 項に記載の光学装置用コーティング組成物。
- (7) 前記ポリシラザンが下記一般式(I):

### [0007]

【0008】(上式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及びR<sup>3</sup> は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、またはこれらの基以外でケイ素に直結する基が炭素である基、アルキルシリル基、アルキルアミノ基、アルコキシ基を表わす。ただし、

 $R^1$  、 $R^2$  及び $R^3$  の少なくとも1つは水素原子である)で表わされる単位からなる主骨格を有する数平均分子量が $100\sim5$  万のポリシラザンである、(1)~

(6)項のいずれか一項に記載の光学装置用コーティン グ組成物。

【0009】本発明の光学装置用コーティング組成物に よると、浸漬法により液晶表示装置などの光学装置又は その基板をコーティングした場合に溶媒がより迅速に乾 燥するため、浸漬法における引き上げ速度を高くしても

2

光学装置にとって許容できる均一な膜厚分布が得られ、 その結果、該光学装置の生産効率が高められる。本発明 は、液晶表示装置をはじめとする光学装置に、対アルカ リ成分遮断性、ガスバリヤ性、耐湿性、電気絶縁性、平 滑性、光学特性、等を一度に付与することができるポリ シラザン由来のセラミックコーティング膜を、より効率 よく大量被覆することができるポリシラザン含有コーテ ィング組成物を提供するものである。本発明は、この目 的のために特別に選定された溶媒を使用することによっ て達成される。

【0010】本発明のコーティング組成物に用いられる 溶媒は、その沸点が室温~約120℃、好ましくは50 ~100℃の範囲にあって、使用するポリシラザンに悪 影響を及ぼすことのない溶媒であれば特に限定はされな い。この沸点が約120℃よりも高いと、上記したよう に溶媒の乾燥速度が低いために浸漬コーティング法にお いて光学装置として許容できる膜厚分布を許容できる施 工効率で達成することが困難となる。反対に、沸点が室 温よりも低い場合には浸漬コーティング液の溶媒蒸発に よる濃度変化が大きくなり、実用的ではない。このよう 20 な溶媒としては、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及び 脂環式炭化水素が挙げられ、その具体例としてシクロへ キサン (沸点81℃)、シクロヘキセン (83℃)、ヘ キサン (69℃)、ベンゼン (80℃)、トルエン (1 10℃)、等が挙げられる。本発明のコーティング組成 物では、これらの溶媒を2種以上組み合わせて使用する ことにより、溶媒の沸点を所望の値に調節することがで きる。例えば、好ましい溶媒混合物として、キシレン+ シクロヘキサン (139~144  $^{\circ}$ ) 、キシレン+シク ロヘキセン、等が挙げられる。

【0011】本発明のコーティング組成物においては、 上記の特定の溶媒の他、ポリシラザンの溶媒として常用 されている上記沸点要件を満たさない溶媒を含むことも できる。この場合、他の溶媒の量は15重量%以下とす ることが好ましい。後述するように、実用上はポリシラ ザンを本発明における特定の溶媒とは別の溶媒、例えば キシレンをはじめとする芳香族炭化水素に、例えば20

【0016】の化学式で表わすことができる。ペルヒド 40 ロポリシラザンの構造の一例を以下に示す。

重量%程度の濃度で溶解させた形で保存することが望ま しく、本発明のコーティング組成物を調製する際には、 こうした濃縮ポリシラザン溶液を上記のような特定の溶 媒で単に希釈することが簡便である。従って、本発明の コーティング組成物にはこのような他の溶媒が典型的に は0~15重量%、好ましくは1~10重量%含まれる ことができる。

【0012】本発明において用いられるポリシラザン は、分子内に少なくともSiーH結合、あるいはNーH 結合を有するポリシラザンであればよく、ポリシラザン 単独は勿論のこと、ポリシラザンと他のポリマーとの共 重合体やポリシラザンと他の化合物との混合物でも利用 できる。用いるポリシラザンには、鎖状、環状、あるい は架橋構造を有するもの、あるいは分子内にこれら複数 の構造を同時に有するものがあり、これら単独でもある いは混合物でも利用できる。

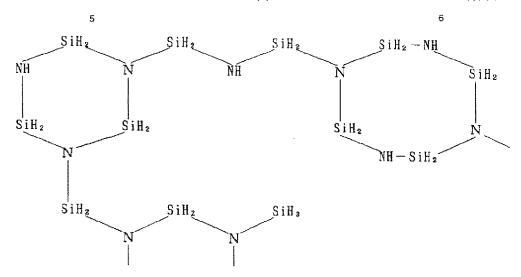
【0013】用いるポリシラザンの代表例としては下記 のようなものがあるが、これらに限定されるものではな い。得られるコーティング膜の硬度(緻密性)の点から はペルヒドロポリシラザンが好ましく、可撓性の点では オルガノポリシラザンが好ましい。また、一般に高温処 理すると特性が損なわれる光学装置や物性が損なわれる プラスチックや強化ガラスの基板にコーティングする場 合には、これらの耐熱温度をも考慮に入れた低温セラミ ックス化ポリシラザンを使用することが好ましい。これ らポリシラザンの選択は、当業者であれば用途に合わせ て適宜行うことができる。

【0014】上記一般式 (I) でR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>に 水素原子を有するものは、ペルヒドロポリシラザンであ り、その製造法は、例えば特公昭63-16325号公 報、D. Seyferth らCommunication of Am. Cer. Soc., C-13. January 1983. に報告されている。これらの方法 で得られるものは、種々の構造を有するポリマーの混合 物であるが、基本的には分子内に鎖状部分と環状部分を 含み、

[0015]  
[
$$(2)$$
  
-(SiH<sub>3</sub>), (a+b+c=1)

[0017] [化3]

30



【0018】一般式(I)でR<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>に水素原子、 R<sup>3</sup> にメチル基を有するポリシラザンの製造方法は、D. Seyferth & Polym. Prepr., Am. Chem. Soc., Div. Po lym.Chem., 25, 10 (1984) に報告されている。この方 法により得られるポリシラザンは、繰り返し単位が一 (SiH2NCH3) -の鎖状ポリマーと環状ポリマー であり、いずれも架橋構造をもたない。一般式(I)で R1 及びR3 に水素原子、R2 に有機基を有するポリオ ルガノ (ヒドロ) シラザンの製造法は、D. Seyferth ら Polym. Prepr., Am. Chem. Soc., Div. Polym. Chem., 25.10(1984)、特開昭61-89230号公報、同6 2-156135号公報に報告されている。これらの方 法により得られるポリシラザンには、一(R2 SiHN H) ーを繰り返し単位として、主として重合度が3~5 の環状構造を有するものや (R3 SiHNH) x 〔(R <sup>2</sup> SiH)<sub>1.5</sub> N]<sub>i-X</sub> (0.4<x<1)の化学式で 示される分子内に鎖状構造と環状構造を同時に有するも のがある。

【0019】一般式(I)で $R^1$  に水素原子、 $R^2$  及び  $R^3$  に有機基を有するポリシラザン、また  $R^1$  及び  $R^2$  に有機基、 $R^3$  に水素原子を有するものは、-( $R^1$   $R^2$  S i N  $R^3$  )一を繰り返し単位として、主に重合度が 3  $\sim$  5 o 環状構造を有している。用いるポリシラザン は、上記一般式(<math>I)で表わされる単位からなる主骨格を有するが、一般式(I)で表わされる単位は、上記にも明らかなように環状化することがあり、その場合にはその環状部分が末端基となり、このような環状化がされない場合には、主骨格の末端は $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  と同様の基又は水素であることができる。

【 O O 2 O 】 ポリオルガノ (ヒドロ) シラザンの中には、D. Seyferth らCommunication of Am. Cer. Soc., C-132, July 1984. が報告されている様な分子内に架橋構造を有するものもある。一例を下記に示す。

[0021]

【化4】

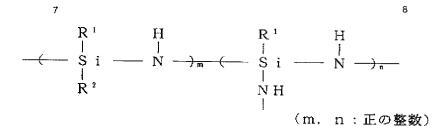
 $R = CH_3$ 

【0.0.2.2】また、特開昭4.9-6.9.7.1.7号公報に報告されている様な $R^1$  S i  $X_3$  (X: ハロゲン)のアンモニア分解によって得られる架橋構造を有するポリシラザン ( $R^1$  S i (NH) x )、あるいは $R^1$  S i  $X_3$  及び $R^2$  S i  $X_2$  の共アンモニア分解によって得られる下

記の構造を有するポリシラザンも出発材料として用いる ことができる。

[0023]

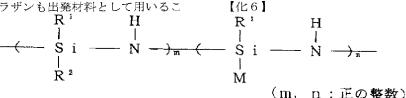
【化5】



とができる。

[0025]

【0024】さらに、下記の構造(式中、側鎖の金属原子であるMは架橋をなしていてもよい)のように金属原子を含むポリメタロシラザンも出発材料として用いるこ



### (Mは金属原子)

【0026】本発明の光学装置用コーティング組成物は、以下のような低温セラミックス化ポリシラザンを使用して調製することもできる。こうした低温セラミックス化ポリシラザンを使用することにより、塗布後に高温焼成ができない耐熱性の低い基板(例えば、プラスチックス)や液晶などを含む光学装置にも、低温セラミックス化処理によって上記と同様の保護コーティングを施工することができる。例えば、本願出願人による特開平5ー238827号公報に記載されているケイ素アルコキシド付加ポリシラザンを使用することができる。この変性ポリシラザンは、上記一般式(I)で表されるポリシラザンと、下記一般式(II):

S i (OR<sup>4</sup>)<sub>4</sub> (II)

(式中、R<sup>4</sup> は、同一でも異なっていてもよく、水素原 30 子、炭素原子数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表し、少なくとも1個のR<sup>4</sup> は上記アルキル基またはアリール基である)で表されるケイ素アルコキシドを加熱反応させて得られる、アルコキシド由来ケイ素/ポリシラザン由来ケイ素原子比が0.001~3の範囲内かつ数平均分子量が約200~50万のケイ素アルコキシド付加ポリシラザンである。

【0027】好適な低温セラミックス化ポリシラザンの別の例として、本出願人による特開平6-122852号公報に記載されているグリシドール付加ポリシラザンが挙げられる。この変性ポリシラザンは、上記一般式(I)で表されるポリシラザンとグリシドールを反応させて得られる、グリシドール/ポリシラザン重量比が0.001~2の範囲内かつ数平均分子量が約200~50万のグリシドール付加ポリシラザンである。好適な低温セラミックス化ポリシラザンのさらに別の例として、本願出願人による特開平6-306329号公報に記載されているアセチルアセトナト錯体付加ポリシラザンが挙げられる。この変性ポリシラザンは、上記一般式

(I) で表されるポリシラザンと、金属としてニッケ

ル、白金、パラジウム又はアルミニウムを含むアセチルアセトナト錯体を反応させて得られる、アセチルアセトナト錯体/ポリシラザン重量比が0.00001~2の範囲内かつ数平均分子量が約200~50万のアセチルアセトナト錯体付加ポリシラザンである。

【0028】好適な低温セラミックス化ポリシラザンのさらに別の例として、本願出願人による特開平6-299118号公報に記載されている金属カルボン酸塩付加ポリシラザンが挙げられる。この変性ポリシラザンは、上記一般式(I)で表されるポリシラザンと、ニッケル、チタン、白金、ロジウム、コバルト、鉄、ルテニウム、オスミウム、パラジウム、イリジウム及びアルミニウムから成る群より選ばれた少なくとも1種の金属を含む金属カルボン酸塩を反応させて得られる、金属カルボン酸塩/ポリシラザン重量比が0.000001~2の範囲内かつ数平均分子量が約200~50万の金属カルボン酸塩付加ポリシラザンである。

【0029】その他の低温セラミックス化ポリシラザンの例として、本願出願人による特開平7-196986 号公報に記載されている金属微粒子添加ポリシラザンが 挙げられる。この変性ポリシラザンは、上記一般式

(1)で表されるポリシラザンを主成分とするコーティング溶液にAu、Ag、Pd、Niをはじめとする金属の微粒子を添加して得られる変性ポリシラザンである。金属微粒子の粒径は $0.5\mu$ mより小さいことが好ましく、さらには $0.05\mu$ mより小さいことが好ましい。特に、粒径 $0.005\mu$ mより小さいことが好ましい。特に、粒径 $0.005\mu$ mより小さいことが好ましい。会属微粒子を高沸点アルコールに分散させたものが好ましい。金属微粒子の添加量は、ポリシラザン100重量部に対して $0.01\sim10$ 重量部、好ましくは $0.05\sim5$ 重量部である。金属微粒子添加ポリシラザンの調製については、上記特開平7-196986号公報を参照されたい。

【0030】本発明により用いることができるポリシラ

50

ザンは、分子量が低すぎるとセラミックス化時の収率が低くなり、実用的でない。一方分子量が高すぎると溶液の安定性が低く、健全なセラミック膜が得られない。これらの理由から、用いるポリシラザンの分子量は数平均分子量で下限は100、好ましくは500である。また、上限は5万、好ましくは10000である。本発明によるコーティング組成物は、用いるポリシラザンの平均分子量、分子量分布、その構造によって異なるが、全組成物重量に対して好ましくは約0.2~10重量%、より好ましくは約2~5重量%のポリシラザンを含有することにより、光学装置用の部品やその甚板の浸漬コーティングにおいて適切な溶媒乾燥速度が達成される。

【0031】また、本発明によるコーティング組成物には、必要に応じて所望の充填剤及び/又は増量剤を加えることができる。充填剤の例としてはシリカ、アルミナ、ジルコニア、マイカを始めとする酸化物系無機物、炭化珪素、窒化珪素等の非酸化物系無機物の微粉、あるいはアクリル樹脂、フッ素樹脂、等の有機化合物、が挙げられる。また用途によってはアルミニウム、亜鉛、銅等の金属粉末の添加も可能である。これら充填剤は、針状(ウィスカーを含む)、粒状、鱗片状等種々の形状のものを単独又は2種以上混合して用いることができる。これら充填剤の粒子の大きさは1回に適用可能な膜厚よりも小さいことが望ましい。また充填剤の添加量はポリシラザン1重量部に対し、0.05~10重量部の範囲であり、特に好ましい添加量は0.2~3重量部の範囲である。

【0032】上記のコーティング組成物には、必要に応じて各種顔料、レベリング剤、消泡剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、pH調整剤、分散剤、表面改質剤、可塑剤、乾燥促進剤、流れ止め剤、等を加えてもよい。本発明によると、上記のようなポリシラザン含有コーティング組成物を光学装置用の部品や基板に塗布し、その塗膜をセラミックス化してポリシラザンを実質的にSiO2へ転化することにより光学装置用のアンダーコートを施工することができる。

【0033】このような基板としては、ソーダガラスをはじめとするガラスの他、種々のプラスチック材料(特に、透明プラスチックス)が包含され、例えば、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリエーテルサルファイド、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、等が挙げられる。本発明によると、上記のような基板の他、光学装置用の部品、例えば液晶表示装置用としてカラーフィルターを搭載した基板や、ITOなどの薄膜電極を有する電極付基板の電極表面にコーティング組成物を直接塗布してオーバーコートとすることもできる。このような光学装置用の部品については、当業者であれば適宜選定することができる。

【0034】光学装置用の部品や基板の面積や厚さには 特に制限はなく、用途に応じた任意の面積及び厚さのガ ラス、プラスチック基材を使用することができる。本発 明によると、上記のようなポリシラザン含有コーティン グ組成物を上記のような部品や基板の両面に浸漬塗布法 で適用することによりポリシラザン膜を形成する。所望 により、塗布前に基板をヤスリがけ、脱脂、各種プラス ト、等で表面処理しておくとコーティング組成物の付着 性が向上する。

【0035】このような方法でコーティングし、十分乾燥させた後、その塗膜に必要に応じて焼成工程を含むセラミックス化工程を施す。このセラミックス化工程によってポリシラザンが架橋、縮合、あるいは、焼成雰囲気によっては酸化、加水分解して硬化し、緻密なセラミック膜を形成する。上記セラミックス化の条件は、用いるポリシラザンの分子量や構造などによって異なる。焼成する場合、その焼成温度はポリシラザンがセラミックス化する温度、通常400℃以上が好ましいが、例えば液晶を含む装置の外部にコーティングを施す場合には、用いる液晶の耐熱温度よりも低い温度、一般には240℃以下、好ましくは200℃以下を採用することが好ましい。

【0036】昇温速度は特に限定しないが、5~20℃ /分の緩やかな昇温速度が好ましい。焼成雰囲気は酸素 中、空気中あるいは不活性ガス等のいずれであってもよ いが、空気中がより好ましい。空気中での焼成によりポ リシラザン又は変性ポリシラザンの酸化、あるいは空気 中に共存する水蒸気による加水分解が進行し、上記のよ うな低い焼成温度でSi-O結合あるいはSi-N結合 を主体とする緻密なセラミック被膜の形成が可能とな る。この被膜は、ポリシラザンに由来するために窒素を 原子百分率で0.005~5%含有する。先に列挙した ような低温セラミックス化ポリシラザンを使用した場合 には、上記のような方法でコーティングした後、液晶及 び/又は基材(特に、プラスチックや強化ガラス)を損 なわない温度、好ましくは150℃以下で加熱処理を施 す。一般に、プラスチック基材の場合、加熱処理を15 0℃以上で行うと、変形や強度劣化などプラスチック基 材が損なわれる。加熱雰囲気は酸素中、空気中のいずれ であってもよい。

【0037】上記の温度での熱処理においてはSi-O、Si-N、Si-H、N-H結合が存在する膜が形成される。この膜はまだセラミックスへの転化が不完全である。この膜を、次に述べる2つの方法①及び②のいずれか一方又は両方によって、セラミックスに転化させることが可能である。

①水蒸気雰囲気中での熱処理。

圧力は特に限定されるものではないが、 $1\sim3$ 気圧が現実的に適当である。相対湿度は特に限定されるものではないが、 $10\sim100$ % R H が好ましい。湿度は室温以上で効果的であるが室温 $\sim150$ ℃が好ましい。熱処理時間は特に限定されるものではないが $10分\sim30$ 日が

現実的に適当である。

【0038】水蒸気雰囲気中での熱処理により、低温セラミックス化ポリシラザンの酸化または水蒸気との加水分解が進行するので、上記のような低い加熱温度で、実質的にSiO2 からなる緻密な膜の形成が可能となる。但し、このSiO2 膜はポリシラザンに由来するため窒素を原子百分率で0.005~5%含有する。この窒素含有量が5%よりも多いと膜のセラミックス化が不十分となり所期の効果(例えば、対酸素遮断性、対湿分遮断性)が得られない。一方、窒素含有量を0.005%よりも少なくすることは困難である。好ましい窒素含有量は原子百分率で0.1~3%である。

【0039】②触媒を含有した蒸留水中に浸す。 触媒としては、酸、塩基が好ましく、その種類について は特に限定されないが、例えば、トリエチルアミン、ジ エチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールア ミン、トリエタノールアミン、nーヘキシルアミン、n ーブチルアミン、ジーnーブチルアミン、トリーnーブ チルアミン、グアニジン、ピグアニン、イミダゾール、 1,8-ジアザビシクロー〔5,4,0〕-7-ウンデ セン、1、4ージアザビシクロー〔2,2,2]ーオク タン等のアミン類;水酸化ナトリウム、水酸化カリウ ム、水酸化リチウム、ピリジン、アンモニア水等のアル カリ類;リン酸等の無機酸類;氷酢酸、無水酢酸、プロ ピオン酸、無水プロピオン酸のような低級モノカルボン 酸、又はその無水物、シュウ酸、フマル酸、マレイン 酸、コハク酸のような低級ジカルボン酸又はその無水 物、トリクロロ酢酸等の有機酸類;過塩素酸、塩酸、硝 酸、硫酸、スルホン酸、パラトルエンスルホン酸、三フ ッ化ホウ素及びその電気供与体との錯体、等; SnCl 4 、ZnCl2、FeCl3、AlCl3、SbC 13 、TiCl4 などのルイス酸及びその錯体等を使用 することができる。好ましい触媒は塩酸である。触媒の 含有割合としては0.01~50重量%、好ましくは1 ~10重量%である。保持温度としては室温から沸点ま での温度にわたって有効である。保持時間としては特に 限定されるものではないが10分~30日が現実的に適 当である。

【0040】触媒を含有した蒸留水中に浸すことにより、低温セラミックス化ポリシラザンの酸化あるいは水 40との加水分解が、触媒の存在により更に加速され、上記のような低い加熱温度で、実質的に $SiO_2$  からなる緻密なセラミック膜の形成が可能となる。但し、先に記載したように、 $CoSiO_2$  膜はポリシラザンに由来するため窒素を同様に原子百分率で $O.005\sim5\%$ 含有する

【0041】本発明では、本願出願人による特願平6-236881号明細書に記載されているセラミックス化 法を採用することもできる。この方法によれば、本発明 のコーティング組成物を基材に塗布し、十分に乾燥した 50 12

後、その塗膜にアルコキシシランと水を含む混合溶液を (例えば、浸漬法や噴霧法により) 接触させるだけで常温においてもポリシラザンがセラミックス化し、実質的に SiO2 からなる緻密なセラミック膜が得られる。この特願平6-236881号明細書に記載されている方法に用いられるアルコキシシランは、ゾルーゲル法による SiO2 系セラミック被膜の形成に一般に用いられるアルコキシシランの中から任意に選ぶことができる。好適なアルコキシシランは、Si(OR)4 [式中、Rは、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アルキルアミノ基またはアルキルシリル基を表す]で示されるアルコキシシランである。

【0042】反応性の混合溶液に用いられる水(H20)には、通常のイオン交換水、工業用水、濾過水、等が使用できる。しかしながら、得られる最終セラミック被膜の膜質等を考慮した場合、純水を使用することが好ましい。また、水の代わりに過酸化水素水を使用することが可能である。混合溶液中のアルコキシシラン/水=0.01~100、より好ましくは0.1~10の範囲が好ましい。この比率が0.01よりも小さいと、水による反応が主体となり、得られるセラミックスの膜質が悪くなる。一方、100よりも大きいと、アルコキシシランの加水分解速度が遅くなる。また、この比率を変更することによって混合溶液の反応性を制御することができる。

【0043】1回の塗布で得られるセラミック被膜の厚 さは、好ましくは $0.01\sim1\mu$ m、より好ましくは  $0.02\sim0.5 \mu$ mの範囲である。膜厚が $2\mu$ mより も厚いとセラミックス化時に割れが入ることが多く、ま た曇りが生じることによりヘイズ率(透明板の場合、3 %以下が好ましい)が増加してしまう。反対に、膜厚が 0.005μmよりも薄いと所期の効果、例えば対アル カリ成分遮断性、ガスバリヤ性、耐湿性、等が得られな い。この膜厚は、コーティング組成物中のポリシラザン 濃度を変更することによって制御することができる。す なわち、膜厚を増加するためにポリシラザン濃度を高く する(溶媒濃度を低くする)ことができる。本発明によ ると、得られるセラミック被膜の膜厚分布の均一性が向 上し、膜厚の変動が一般に±7%以内、好ましくは±2 %以内のセラミック被膜が得られ、光学装置、例えば液 晶表示装置に使用するのに十分な膜厚均一性(好ましく は±5%以内)を示すセラミックス被膜が得られる。

【0044】こうして、本発明によりポリシラザン含有コーティング組成物をセラミックス化すると、ガラス基板から溶出してくるアルカリ成分や、大気中の湿分及び酸素に対する遮断性に優れた緻密な実質的にSiO2からなる膜厚分布の均一なセラミックスコーティング膜が得られる。

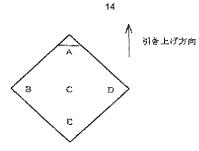
## [0045]

#### 【実施例】

#### 実施例1

ポリシラザンをシクロヘキサンに溶解し、ポリシラザン 濃度2%のコーティング組成物を調製した。比較用コー ティング組成物としてポリシラザンをキシレンに溶解 し、ポリシラザン濃度2%の組成物も調製した。これら のコーティング組成物を下記のような正方形のガラス基 板に下記の引き上げ方向で引き上げ速度200mm/ 分、500mm/分及び700mm/分において浸漬塗 10 厚を上記A、B、C、D及びEの各点において触針式の 布した。

## [0046] 【化7】



【0047】浸漬後、大気雰囲気下、450℃で焼成す ることによりセラミックス被膜を形成させた。その被膜 膜厚計で測定した。結果を以下の表1にまとめる。

[0048]

表 1	〔膜厚単位	:	オングス	ŀ	□ <b>-</b>	· [A	

引き上げ速度	2	0	0	mm/分

測定地点	シクロヘキサン蓉液	キシレン溶液
A	3 0 0	275
В	3 2 5	290
С	3 3 0	285
D	3 3 0	3 2 0
E	3 4 0	380

#### 引き上げ速度500mm/分

<u>測定地点</u>	シクロヘキサン溶液	キシレン溶液
A	500	5 2 0
В	5 4 0	5 8 5
С	5 4 5	5 2 0
D	5 5 0	5 8 5
F.	560	635

### 引き上げ速度700mm/分

測定地点	シクロヘキサン溶液	キシレン溶液
A	7 1 0	680
В	7 1 5	690
C	7 1 5	7 2 0
D	7 1 0	670
E	720	800

#### 【0049】実施例2

ポリシラザンを95%シクロヘキサン+5%キシレンの 混合溶剤に溶解し、ポリシラザン濃度2%のコーティン グ組成物を調製した。比較用コーティング組成物として ポリシラザンをキシレンに溶解し、ポリシラザン濃度2 4c の各点において触針式の膜厚計で測定した。結果を以下 %の組成物も調製した。これらのコーティング組成物を 上記と同様の正方形のガラス基板に上記の引き上げ方向

表 2 〔膜厚単位:オングストローム〕

引き上げ速度200mm/分

シクロヘキサントキシレン キシレン溶液 測定地点 2 7 5 3 0 5 Α 290 В 3 2 5 285  $\mathsf{C}$ 3 2 7 D 3 3 0 320 E 338 380

で引き上げ速度200mm/分、500mm/分及び7 00mm/分において浸漬塗布した。浸漬後、大気雰囲 気下、450℃で焼成することによりセラミックス被膜 を形成させた。その被膜厚を上記A、B、C、D及びE の表2にまとめる。

[0050]

# 引き上げ速度500mm/分

測定地点	シクロヘキサン+キシレン	キシレン溶液
Α	5 0 5	5 2 0
В	5 4 4	5 8 5
С	5 4 9	5 2 0
D	5 5 3	585
E	5 6 1	635

### 引き上げ速度700mm/分

測定地点	シクロヘキサン+キシレン	キシレン溶液
A	7 0 3	680
В	7 0 8	690
C	708	7 2 0
D	7 1 0	. 670
E	715	800

### [0051]

【発明の効果】本発明の光学装置用コーティング組成物によると、浸漬塗布法により液晶表示装置のような光学 装置の部品やその基板をコーティングした場合に溶媒が より迅速に乾燥するため、浸漬塗布法における引き上げ 速度を高くしても光学装置にとって許容できる均一な膜 厚分布が得られ、該光学装置の生産効率が高められる。